

コネクティッド社会へ向けたディスプレイ および高信頼性化技術の最新動向

Advanced Encapsulation Technologies for Highly Reliable Displays in IoT Society = "Connected Society"

竹田 諭司 (MirasoLab 代表) 著

- コネクティッド社会を支える技術の基礎から最新動向までを解説！
- ディスプレイ業界&高信頼性化技術の最新動向を把握！
- 有機ELにおいて今後必要とされる技術を解説！
- マイクロLED・量子ドットディスプレイ関連封止を詳述！

<発行要項>

- 発行：2018年10月5日発行
- 定価：60,000円＋税
- 体裁：A4判・並製・110頁
- 編集・発行：(株)シーエムシー・リサーチ
- ISBN 978-4-904482-52-0

= 刊行にあたって =

本書では、あらゆるモノがインターネットに繋がるコネクティッド社会において、人間とモノとを繋ぐコミュニケーションインターフェースとして重要な役割を果たすディスプレイに焦点をあて、今後本格化する当該社会においてKeyとなる高信頼性化技術をテーマに詳しく解説する。

コネクティッド社会とは具体的にどのような社会なのか、またその社会をどのような技術が支えるのかについてまず解説し、それを踏まえ、キーデバイスとなるディスプレイを取り上げ、業界の最新動向およびディスプレイの高信頼性化技術に特化し、その現状と動向について詳しく述べる。

したがって、本書1冊により、コネクティッド社会の全体感、および、ディスプレイ業界&高信頼性化技術の最新動向が把握できる構成となっている。

特に、高信頼性化技術については、ディスプレイのみならず幅広い分野に共通する重要技術であるにもかかわらず、関連書籍が極めて少ないことから、できる限り多くの情報を盛り込み全体感が把握できるよう努めた。

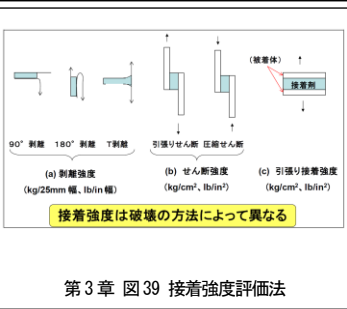
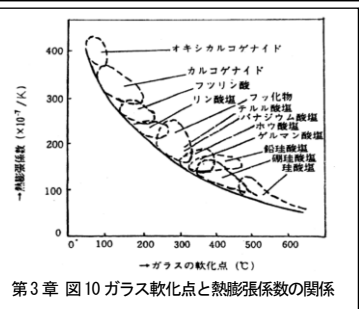
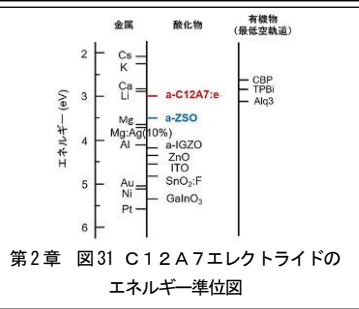
本書をきっかけに、読者の方々がコネクティッド社会、ディスプレイ、高信頼性化技術に少しでも興味を持って頂ければ幸いです。同時に、本書の内容について厳しい御叱責をお願いする次第である。

竹田 諭司

著者略歴

1992年旭硝子(株)入社。中央研究所にて複数の新商品・新技術開発および製品・製造トラブル対応に従事。2002年より米国イリノイ大学留学、新材料&プロセス開発に従事。2007年よりエレクトロニクス事業部の新事業プロジェクトリーダー、複数の新規事業の企画・立上げ・事業化推進に従事。2017年9月旭硝子を退職。同年10月 MirasoLab 代表就任。

第1章 図9 コネクティッド社会における作業イメージ



注文書		メルマガ登録	登録済み	登録希望	お申込み・お問合せ	
品名	コネクティッド社会へ向けたディスプレイ および高信頼性化技術の最新動向	価格	定価(書籍) : 60,000円+税 書籍+CDセット : 70,000円+税 メルマガ会員 書籍 : 54,000円+税 書籍+CDセット : 63,000円+税		編集発行： (株)シーエムシー・リサーチ 101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7 東和錦町ビル3F	
会社名		TEL			TEL : 03 (3293) 7053 FAX : 03 (3291) 5789	
部課名		FAX			URL: http://www.cmcre.com E-mail : re@cmcre.com	
お名前		E-mail				
住所	〒					

*書籍はご注文を受けた翌営業日に納品書・請求書とともに送付します。
*お支払いは請求書指定口座に納品日の翌月末日までに振り込みでお願いします。

構成および内容

第1章 コネクティッド社会

- 1 コネクティッド社会とは
- 2 コネクティッド社会を支える技術
 - 2.1 センサー技術
 - 2.2 高速データ通信技術
 - 2.3 高速データ処理技術
- 3 コネクティッド社会の課題

第2章 ディ스플레이

- 1 ディ스플레이の役割
- 2 ディ스플레이の現状
 - 2.1 ディ스플레이の発展
 - 2.2 液晶ディスプレイ
 - 2.2.1 市場動向
 - 2.2.2 液晶ディスプレイの特徴と製造プロセス
 - 2.2.3 液晶ディスプレイの業界構造
 - 2.3 有機ELディスプレイ
 - 2.3.1 市場動向
 - 2.3.2 有機ELディスプレイの特徴
 - 2.3.3 有機ELディスプレイの発光原理と製造プロセス
 - 2.3.4 有機ELの課題
 - 2.4 有機ELにおいて今後必要とされる技術
 - 2.4.1 高移動度 TFT
 - 2.4.2 デバイス安定性の向上
 - 2.4.3 高発光材料
 - 2.4.4 高信頼薄膜封止技術
 - 2.5 次世代ディスプレイ

- 2.5.1 マイクロLEDディスプレイ

- 2.5.2 量子ドットディスプレイ

- 3 コネクティッド社会におけるディスプレイ
 - 3.1 空中ディスプレイ
 - 3.2 空中超音波触覚ディスプレイ
 - 3.3 ライトフィールドディスプレイ
 - 3.4 その他

第3章 高信頼性化

- 1 高信頼性化の重要性
- 2 封止技術の現状
 - 2.1 有機ELに求められる封止性能と評価法
 - 2.2 封止技術
 - ①樹脂封止
 - ②薄膜封止
 - ③ガラス封止
 - 2.3 レーザーガラス封止
 - 2.3.1 ガラス接着剤
 - 2.3.2 有機ELディスプレイ
 - 2.3.3 酸化物 TFT
 - 2.3.4 高耐久ミラー
 - 2.3.5 太陽電池モジュール
 - 2.3.6 真空断熱ガラス
 - 2.3.7 セラミックスパッケージ
 - 2.3.8 異種材料接着・接合
 - 2.4 接着強度評価法
 - 2.5 大型フレキシブルディスプレイ封止
 - 2.6 他のディスプレイ（マイクロLED・量子ドットディスプレイ）関連封止
- 3 コネクティッド社会における高信頼性化技術